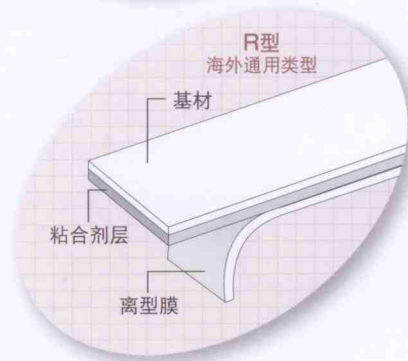


底片保护用胶带

TACKWELL#150系列

TACKWELL # 150系列是在无尘室里将透明特殊粘合剂薄薄均匀地涂布在超薄聚酯膜上的胶带,特别适用于印刷电路板(PCB)工序用底片的表面保护。



特点

- 准备了6~20 μm 厚度的精确度良好的胶带。
- 薄膜、粘合剂的透明度均很高,不会影响光学特性。
- 所有产品均在无尘室制造。
- 刚敷膜后的粘合力,适当的被调整,易于重新粘贴。
- 胶带表面进行过离型处理,可防止沾上绿漆。
#157SD具有极高的耐溶剂性,可长期防止粘上绿漆。
- 为高密度配线板专用的等级而开发。
使用平行光曝光机,具有良好的图形再现性。

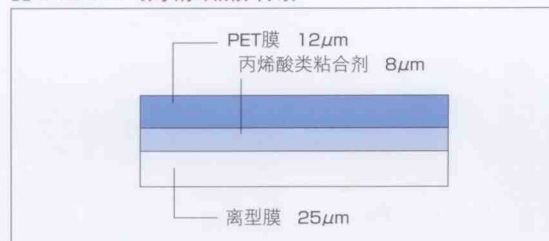
产品阵营

■ #150 (通用型)

DFR用

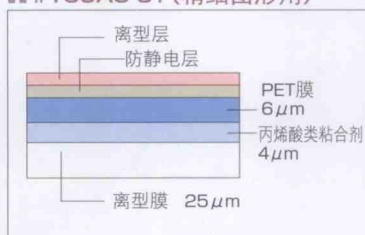


■ #155FP (高精细底片用)



液状绿漆

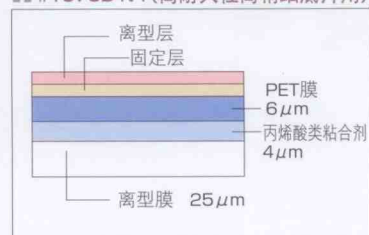
■ #155AS-ST (精细图形用)



■ #157SD (高耐久性型)



■ #157SD-N4 (高耐久性高精细底片用)



特性

■ 一般物性

项目	单位	#150	#155FP	#155AS-ST	#157SD	#157SD-N4
粘合力(PET)	N/25mm	2.4	3.9	2.4	2.4	2.4
全光线透过率	%	90.8	91.6	93.8	93.5	93.5
Haze(雾度)	%	2.7	1.1	2.7	2.6	2.5
表面固有电阻值	Ω/\square	1×10^{14}	1×10^{14}	1×10^{11}	1×10^{14}	1×10^{14}

*粘合力的测试方法是根据旧JIS Z 0237 *以上数据为测量值,非保证值。

高耐久型

TACKWELL#157SD 绿漆用

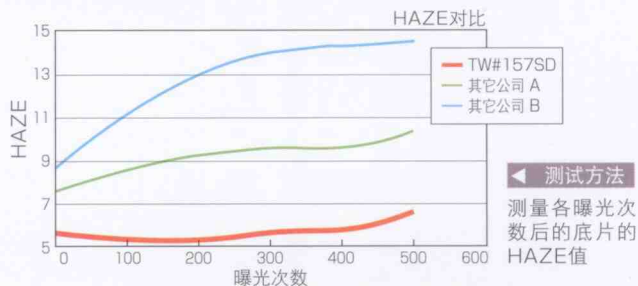
防止由于溶剂引起的离型层脱落,即使是高粘连性的液状湿膜,可容易从底片剥离。

有些无卤型和封装基板用液状绿漆使用特殊溶剂,该溶液会使离型层脱落,因此仅经过几次曝光后就必须更换胶带。

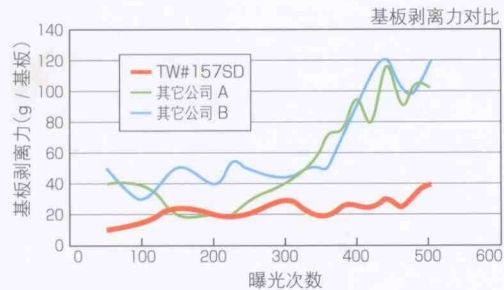
TACKWELL # 157SD可防止此类溶剂引起的离型层脱落,并且通过大幅提高TACKWELL的耐久性,在使用液状绿漆时保护膜的更换次数可减少到最小限度。

而且,由于具有杰出的光学特性,也最适用于BGA等高密度封装基板。

底片雾度测试



离型层脱落测试



测试方法

各曝光次数后测量底片(敷保护膜)与基板的剥离力。

积水测试方法(密接曝光测试)

按照实际的基板曝光方式,多次曝光,进行测试。

绿漆	太阳油墨AUS308
基板	0.8mm(t)玻璃纤维环氧树脂铜厚35微米两面
真空密接	-75cmHg × 1分钟

*以上数据为测量值,非保证值。

高精细底片保护膜

TACKWELL #155FP 精细图形用

控制UV平行曝光的散乱,提高30 μ m以下精细图形的再现性。

以往,如果在底片上粘贴保护膜,难以形成50 μ m以下的窄幅图形。TACKWELL # 155FP通过UV区域的高透明化和大幅减少卷入气泡,可控制曝光光的散乱,易于形成精细图形。

不仅限于膜掩膜,还可用于玻璃掩膜。

与以前的液状和涂层型不同,仅通过层压便可粘合,便于操作。

物理特性对比

项目	单位	#155FP	本公司现有产品
总厚度	μ m	20	10
全光线透过率	%	91.6	93.6
400nm光线透过率	%	85.1	81.8
Haze(雾度)	%	1.2	7.3
散乱率	%	1.0	6.8
用途		高密度封装基板	通用印刷电路板

*以上数据为测量值,非保证值。

粘帖 #155FP, 曝光、成像

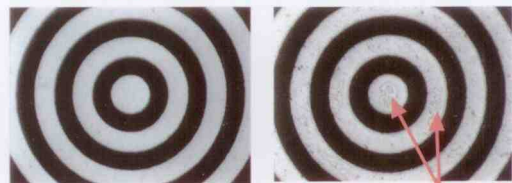


形成的线宽(μ m)/光掩膜的线宽(μ m)

配线间卷入气泡

TACKWELL#155FP

本公司以前产品 L/S=50/50



卷入气泡

透镜效果原理

如有气泡,由于气泡产生的透镜效果,造成清晰度下降。

